Medieninformation

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Ihr Ansprechpartner
Falk Lange

Durchwahl
Telefon +49 351 564 60200

falk.lange@smwk.sachsen.de*

02.04.2014

Europa forscht: Schlüsselprojekt „eRamp“ zur Stärkung der europäischen Elektronikindustrie unter Leitung von Infineon gestartet

Der Startschuss für eines der bedeutendsten europäischen Forschungsprojekte zum Thema Energieeffizienz ist heute bei Infineon Technologies in Dresden gefallen. Das drei Jahre laufende Projekt „eRamp“ hat zum Ziel, Deutschland und Europa als Kompetenzstandort für die Herstellung von Leistungselektronik weiter zu stärken und auszubauen. Daran arbeiten 26 Forschungspartner aus sechs Ländern. Als Weltmarktführer für Leistungshalbleiter leitet Infineon das 55-Millionen-Euro-Projekt.

An der zweitägigen Kick-Off-Veranstaltung zu eRamp (02.-03.04.2014) nehmen die Projektpartner teil sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fördergeber und der Politik. Dr. Reinhard Ploss, der Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies AG, trifft sich zum Auftakt der Veranstaltung u.a. mit Sabine von Schorlemer, der Sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, mit Prof. Wolf-Dieter Lukas, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als dem größten nationalen Fördergeber, sowie mit Dr. Andreas Wild, dem geschäftsführenden Direktor des europäischen Fördergebers ENIAC Joint Undertaking.

„Die Forschungsergebnisse von eRamp werden dazu beitragen, elektrische Energie noch effizienter zu nutzen“, sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Europa und Deutschland differenzieren sich über Wissen und Kompetenz. Die eRamp-Projektpartner haben die gesamte Wertschöpfungskette der Leistungselektronik von der Erzeugung, der Übertragung bis zum Verbrauch elektrischer Energie im Blick. So erarbeiten wir zusammen neues Wissen und damit neue Produkte, die Europa wirtschaftlich und ökologisch voranbringen.“

* Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.lsf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzungen.

Prof. Wolf-Dieter Lukas, Abteilungsleiter im BMBF, sagt: „Leistungselektronik ist eine Schlüsseltechnologie, die mitentscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit we-sentlicher Industriebranchen in Deutschland und Europa. Das kohärente Vorgehen von Europäischer Kommission und Bundesregierung bei der Förderung von eRamp zeigt die Vorteile gemeinsamen Handelns in Europa."

„Das Projekt eRamp unter der Federführung von Infineon Technologies Dresden bringt die Europäische Industrie bei Bauelementen für die Leistungselektronik an die Spitze der Innovation, mit erheblicher Auswirkung auf wichtige Gebiete der Industrie und des täglichen Lebens, wie Energieeffizienz, Elektromobilität, Medizin und viele andere", fasst Dr. Andreas Wild, geschäftsführender Direktor der ENIAC Joint Undertaking, das Vorhaben zusammen.

„Bei den meisten Innovationen, mit denen deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt erfolgreich sind, handelt es sich bei näherem Hinsehen um solche der Elektronik und/oder der Software. Das gilt für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Medizintechnik oder die Umwelttechnik. Deswegen dürfen wir uns in der Mikroelektronik nicht von außereuropäischen Herstellern abhängig machen", stellt die auch für Technologiepolitik zuständige Wissenschaftsministerin Sachsens Sabine von Schorlemer fest.

eRamp stärkt Deutschland und Europa als Kompetenzstandort für die Herstellung von Leistungselektronik:

Im Mittelpunkt der eRamp-Forschungsarbeiten steht die schnellere Einführung neuer Fertigungstechniken und die weitere Erforschung von Gehäusetechnologien für Leistungshalbleiter. Aufgabe der deutschen Projektpartner ist es, neue Methoden für einen schnelleren Fertigungsanlauf zu erforschen und zu entwickeln.

Um die Forschungsergebnisse gleich dort auf ihre Praxistauglichkeit hin zu untersuchen, wo die neuen Fertigungstechniken letztendlich eingesetzt werden, nutzen die Forschungspartner bestehende Pilotlinien und umfangreiches Fertigungs-Know-how an verschiedenen Standorten; u.a. in Dresden (Infineon: Leistungshalbleiter auf Basis von 300-mm-Wafern), in Reutlingen (Bosch: Leistungshalbleiter, Smart Power und Sensoren auf Basis von 200-mm-Wafern) und in Regensburg (Infineon: Gehäusetechnologie für Leistungshalbleiter). Zur Bewertung einer neu entwickelten Chip-Embedding-Technologie werden Infineon, Osram und Siemens in enger Zusammenarbeit Testaufbauten und Demonstratoren anfertigen und erforschen.

In Deutschland forschen die Technische Universität Dresden und die Westsächsische Hochschule Zwickau mit. Neben Bosch, Infineon, Osram und Siemens sind seitens der deutschen Wirtschaft die Unternehmen SYSTEMA Dresden, ein IT-Spezialanbieter für die Automatisierung in der Fertigungsindustrie, mit dabei sowie HSEB Dresden, ein Anbieter für optische Inspektion, Review und Montage, und SGS INSTITUT FRESENIUS, ein führender Dienstleister für chemische und physikalische Laboranalysen.

Mehr Energieeffizienz durch Leistungselektronik:

Leistungselektronik umfasst Elektronikkomponenten und die in ihnen verbauten Chips – sogenannte Leistungshalbleiter. Leistungshalbleiter helfen, den Verlust von elektrischer Energie möglichst gering zu halten. Sie sorgen dafür, möglichst viel der durch Wind oder Sonne gewonnenen elektrischen Energie ins Stromnetz einzuspeisen, den Strom fast verlustfrei über viele tausend Kilometer vom Ort der Erzeugung zum Verbraucher zu bringen und dann den Stromverbrauch in den unterschiedlichsten Anwendungen zu senken; z.B. in Haushaltsgeräten, in der Beleuchtungstechnik, in Servern und Computern, in Hybrid- und Elektroantrieben von Autos, Nutz-, Bau- und Landmaschinen sowie in der Energietechnik und in Fertigungsanlagen der Industrie.

eRamp - ein starkes Team mit 26 Forschungspartnern aus sechs Ländern:

Die Forschungspartner im eRamp-Projekt sind in alphabetischer Reihenfolge: AMS AG (Unterpremstatten, Österreich), CISC Semiconductor GmbH (Klagenfurt, Österreich), HSEB Dresden GmbH (Dresden), Infineon Technologies (Dresden, Regensburg, München; Villach in Österreich und Bukarest in Rumänien), JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH (Graz, Österreich), Lantiq (Villach, Österreich), Materials Center Leoben Forschung GmbH (Leoben, Öster-reich), NXP Semiconductors (Gratkorn, Österreich, und Eindhoven, Niederlande), Osram GmbH (München), Polymer Competence Center Leoben GmbH (Leoben, Österreich), Robert Bosch GmbH (Stuttgart), SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH (Taunusstein), Siemens AG (Berlin, München), SPTS Technologies Ltd (Newport, UK), Stichting IMEC Nederland (Eindhoven, Niederlande), SYSTEMA Systement-wicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH (Dresden), Technische Universität Bra-tislava (Slowakei), Technische Universität Dresden, Technische Universität Wien, Universität Innsbruck und die Westsächsische Hochschule Zwickau.

Das Projekt eRamp wird von ENIAC Joint Undertaking und von Deutschland,

Österreich, den Niederlanden, Rumänien, der Slowakische Republik und dem Vereinigten Königreich finanziell unterstützt.

Über Infineon:

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.